

2019年中国芯片设计行业分析报告- 市场发展现状与发展机会预测

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2019年中国芯片设计行业分析报告-市场发展现状与发展机会预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yingjian/464794464794.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

【报告大纲】

第一章芯片设计行业相关概述

1.1芯片的概念和分类

1.1.1芯片基本概念

1.1.2相关概念区分

1.1.3芯片主要分类

1.2芯片产业链结构

1.2.1芯片产业链结构

1.2.2芯片生产流程图

1.2.3产业链核心环节

1.3芯片设计行业概述

1.3.1芯片设计行业简介

1.3.2芯片设计基本分类

1.3.3芯片设计产业图谱

第二章2016-2019年中国芯片设计行业发展环境

2.1经济环境

2.1.1宏观经济发展概况

2.1.2工业经济运行情况

2.1.3经济转型升级态势

2.1.4未来经济发展展望

2.2政策环境

2.2.1智能制造发展战略

2.2.2中国制造支持政策

2.2.3集成电路相关政策

2.2.4芯片产业政策汇总

2.2.5产业投资基金支持

2.3社会环境

2.3.1移动网络运行状况

2.3.2电子信息制造规模

2.3.3研发经费投入增长

2.3.4科技人才队伍壮大

2.4技术环境

2.4.1芯片领域专利状况

2.4.2芯片技术数量分布

2.4.3芯片技术研发进展

2.4.4芯片技术创新升级

2.4.5芯片技术发展方向

第三章中国芯片产业发展分析

3.12016-2019年中国芯片产业发展综述

3.1.1产业基本特征

3.1.2产业发展背景

3.1.3产业发展意义

3.1.4产业发展进程

3.1.5产业发展提速

3.22016-2019年中国芯片市场运行状况

3.2.1产业销售规模

3.2.2市场结构分析

3.2.3产品产量规模

3.2.4企业竞争状况

3.2.5区域发展格局

3.2.6市场应用需求

3.3中国集成电路进出口数据分析

3.3.1进出口总量数据分析

3.3.2主要贸易国进出口情况分析

3.3.3主要省市进出口情况分析

3.42016-2019年中国芯片国产化进程分析

3.4.1芯片国产化发展背景

3.4.2核心芯片的自给率低

3.4.3芯片国产化进展分析

3.4.4芯片国产化存在问题

3.4.5芯片国产化未来展望

3.5中国芯片产业发展困境分析

3.5.1市场垄断困境

3.5.2过度依赖进口

3.5.3技术短板问题

3.5.4人才短缺问题

3.6中国芯片产业应对策略分析

3.6.1突破垄断策略

3.6.2化解供给不足

3.6.3加强自主创新

3.6.4加大资源投入

第四章2016-2019年芯片设计行业发展全面分析

4.12016-2019年全球芯片设计行业发展综述

4.1.1市场发展规模

4.1.2市场区域格局

4.1.3市场竞争格局

4.1.4企业排名分析

4.22016-2019年中国芯片设计行业运行状况

4.2.1行业发展历程

4.2.2市场发展规模

4.2.3市场竞争格局

4.2.4产品类型分布

4.2.5细分市场发展

4.3芯片设计企业发展状况分析

4.3.1企业数量规模

4.3.2企业运行状况

4.3.3企业地域分布

4.3.4设计人员规模

4.4芯片设计行业上市公司财务状况分析

4.4.1上市公司规模

4.4.2上市公司分布

4.4.3经营状况分析

4.4.4盈利能力分析

4.4.5营运能力分析

4.4.6成长能力分析

4.4.7现金流量分析

4.5芯片设计具体流程剖析

4.5.1规格制定

4.5.2设计细节

4.5.3逻辑设计

4.5.4电路布局

4.5.5光罩制作

4.6芯片设计行业发展存在的问题和对策

4.6.1行业发展瓶颈

4.6.2行业发展困境

4.6.3产业发展建议

4.6.4产业创新策略

第五章2016-2019年中国芯片设计行业细分产品发展分析

5.1逻辑IC产品设计发展状况

5.1.1CPU

5.1.2GPU

5.1.3MCU

5.1.4ASIC

5.1.5FPGA

5.1.6DSP

5.2存储IC产品设计发展状况

5.2.1DRAM

5.2.2NANDFlash

5.2.3NORFlash

5.3模拟IC产品设计发展状况

5.3.1射频器件

5.3.2模数/数模转换器

5.3.3电源管理产品

第六章中国芯片设计工具——EDA（电子设计自动化）软件市场发展状况

6.1EDA软件基本概述

6.1.1EDA软件基本概念

6.1.2EDA软件的重要性

6.1.3EDA软件主要类型

6.1.4EDA软件设计过程

6.1.5EDA软件设计步骤

6.2中国芯片设计EDA软件行业发展分析

6.2.1行业发展规模

6.2.2市场竞争状况

6.2.3国产EDA机遇

6.2.4行业发展瓶颈

6.2.5行业发展对策

6.3集成电路EDA行业竞争状况

6.3.1市场竞争格局

6.3.2国际EDA企业

6.3.3国内EDA企业

6.4EDA技术及工具发展沿革及作用

6.4.1GDS&GDSII

6.4.2SPICE

6.4.3半导体器件模型 (SPICEModel)

6.4.4硬件描述语言 (HDL)

6.4.5静态时序分析

第七章中国芯片设计产业园区建设分析

7.1深圳集成电路设计应用产业园

7.1.1园区发展环境

7.1.2园区基本简介

7.1.3园区战略定位

7.1.4园区服务内容

7.2北京中关村集成电路设计园

7.2.1园区发展环境

7.2.2园区基本简介

7.2.3园区战略定位

7.2.4园区发展状况

7.2.5园区企业合作

7.2.6园区发展规划

7.3上海集成电路设计产业园

7.3.1园区发展环境

7.3.2园区基本简介

7.3.3园区入驻企业

7.3.4园区项目建设

7.3.5园区发展规划

7.4无锡国家集成电路设计产业园

7.4.1 园区发展环境

7.4.2 园区基本简介

7.4.3 园区发展状况

7.4.4 园区区位优势

7.5 杭州集成电路设计产业园

7.5.1 园区发展环境

7.5.2 园区基本简介

7.5.3 园区签约项目

7.5.4 园区发展规划

第八章 国外芯片设计重点企业经营状况

8.1 博通 (Broadcom)

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业经营状况分析

4、企业竞争优势分析

8.2 高通 (Qualcomm)

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业经营状况分析

4、企业竞争优势分析

8.3 英伟达 (NVIDIA)

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业经营状况分析

4、企业竞争优势分析

8.4 超微 (AMD)

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业经营状况分析

4、企业竞争优势分析

8.5 赛灵思 (Xilinx)

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业经营状况分析

4、企业竞争优势分析

第九章国内芯片设计重点企业经营状况

9.1联发科

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业产品服务分析
- 3、企业经营状况分析
- 4、企业竞争优势分析

9.2华为海思

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业产品服务分析
- 3、企业经营状况分析
- 4、企业竞争优势分析

9.3紫光展锐

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业产品服务分析
- 3、企业经营状况分析
- 4、企业竞争优势分析

9.4中兴微电子

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业产品服务分析
- 3、企业经营状况分析
- 4、企业竞争优势分析

9.5华大半导体

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业产品服务分析
- 3、企业经营状况分析
- 4、企业竞争优势分析

9.6汇顶科技

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业产品服务分析
- 3、企业经营状况分析
- 4、企业竞争优势分析

9.7兆易创新

- 1、企业发展简况分析

- 2、企业产品服务分析
- 3、企业经营状况分析
- 4、企业竞争优势分析

第十章芯片设计行业投资价值综合分析

10.1集成电路产业投资价值评估及投资建议

10.1.1投资价值综合评估

10.1.2市场机会矩阵分析

10.1.3产业进入时机分析

10.1.4产业投资风险剖析

10.1.5产业投资策略建议

10.2芯片设计行业进入壁垒评估

10.2.1行业竞争壁垒

10.2.2行业技术壁垒

10.2.3行业资金壁垒

10.3芯片设计行业投资状况分析

10.3.1产业投资规模

10.3.2产业投资热点

10.3.3基金投资策略

10.3.4投资项目分析

第十一章2020-2026年芯片设计行业发展趋势和前景预测分析

11.1中国芯片市场发展机遇分析

11.1.1产业发展机遇分析

11.1.2市场变动带来机遇

11.1.3产业未来发展趋势

11.2中国芯片设计行业发展前景展望

11.2.1技术创新发展

11.2.2市场需求状况

11.2.3行业发展前景

11.32020-2026年中国芯片设计行业预测分析

11.3.12020-2026年中国芯片设计行业影响因素分析

11.3.22020-2026年中国芯片设计行业销售规模预测

图表目录

图表1芯片产品分类

图表2集成电路产业链及部分企业

图表3芯片生产历程

图表4芯片设计产业图谱

图表52016-2019年国内生产总值及其增长速度

图表62016-2019年三次产业增加值占国内生产总值比重

图表72019年中国GDP核算数据

图表82019年规模以上工业增加至同比增长速度

图表92019年规模以上工业生产主要数据

图表102016-2019年规模以上工业增加值同比增长速度

图表112019年规模以上工业生产主要数据

图表12智能制造系统架构

图表13智能制造系统层级

图表详见报告正文..... (GY YXY)

【简介】

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2019年中国芯片设计行业分析报告-市场发展现状与发展机会预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局

及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yingjian/464794464794.html>